

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2023年12月27日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 ()
参与单位名称	开源证券、平安养老保险、中银证券
活动时间	2023年12月27日
活动地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司三季度的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、目前 NOR Flash 的玩家很多，公司对于 NOR Flash 产品是如何规划？ 答：公司专注于中大容量、ETOX 工艺的 NOR Flash 产品，容量涵盖 64Mb 至 1Gb，充分满足功能手机、TWS 耳机等可穿戴设备领域以及移动终端领域的需求。公司将持续完善 NOR Flash 产品线，为更多客户提供中高容量、高可靠性的 NOR Flash 产品。</p> <p>2、网通板块公司主要涉及哪些终端应用？ 答：公司产品在网通领域的主要应用包括 5G 宏基站、微基站、光猫、WiFi、随身的 Mifi 等。</p> <p>3、公司募投项目的进展如何？ 答：1) 公司 1xnm 先进制程的 SLC NAND Flash 产品已完成了晶圆制造，目前正在产品调试的过程中。2) 目前公司已有产品通过 AEC Q-100 的认证，正在积极进行客户导入工作，在产品布局方面公司也是不断从工业级向车规级发展。3) 研发中心建设项目是公司现有的、通用的、中小容量的存储产品的基础上去做的产品深度的延伸，希望能够为将来奠定更加多元化的、差异化的产品基础，目前尚处于研发阶段。具体情况还请关注今后发布的定期报告。</p> <p>4、请问公司对于 SLC NAND、NOR、DRAM 产品占公司营收情况是如何规划的？ 答：目前 SLC NAND Flash 作为公司的主力产品，营</p>

	<p>收占比相对较高。从公司的长期发展来看，NAND Flash、NOR Flash、DRAM 产品都会是公司重点发展的领域。5、公司的 DRAM 产品有哪些？</p> <p>答：一是标准的 DDR3，容量从 1Gb 到 4Gb，这部分的产品主要是用在消费领域，像 OTT、IPTV 这些产品上面。二是低功耗的 LPDDR 产品，包括 LPDDR1、LPDDR2 以及在开发中的 LPDDR4。低功耗 LPDDR 产品可以和我们的 SLC NAND 合封成 NAND MCP，目前主要应用在工业模块市场。</p>
日期	2023 年 12 月 29 日